

Power SMDパッケージ

Power SMD Package

超小型パッケージ製品群 Mini-MOSシリーズ/L-MOSシリーズ

新製品

■ US-FLAT™: Ultra Small FLAT

従来品S-FLAT (1.6 × 3.5) をさらに小型 (1.25 × 2.5)、薄型化 (0.98 → 0.6mm) した新パッケージです。

■ M-FLAT™: Medium FLAT

従来品I-FLATと同等のチップを内蔵した薄型 (1.9 → 0.98mm) 新パッケージです。

新製品

■ VS-6: Very thin and Small-6pin

■ TSM: Thin Super Mini

従来S-MINIに対しフレーム素材に熱伝導特性の優れた銅系合金を使用し熱抵抗を大幅に改善、またチップ厚の薄化とワイヤの低ループ化によりパッケージ厚さを約 40% 薄くしました。

■ VS-8: Very thin and Small-8pin

従来TSSOPに対し外部引出しリードのフラット化による放熱性、インピーダンスを改善し、小型、薄型化を実現しました。

